

외부 구조만 다른 MCU 사용의 전기온돌 침대 변경신고 절차 안내

RRA KSDB 제15호 (2021.11.22.)

□ 개 요

- 전기온돌 침대에 사용되는 온도조절장치 보드(이하'MCU')의 PCB 기판이 바뀌지 않고 외부 핀 형태 등만 다른 CPU를 사용하는 경우의 변경신고 절차문의 답변을 공유하고자 함

□ 근 거

- 「전파법」 제58조의2(방송통신기자재등의 적합성평가)
- 「전파법 시행령」 제77조의2(적합인증), 제77조의3(적합등록), 제77조의4(적합성평가의 변경신고)
- 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제5조, 제16조

□ 내 용

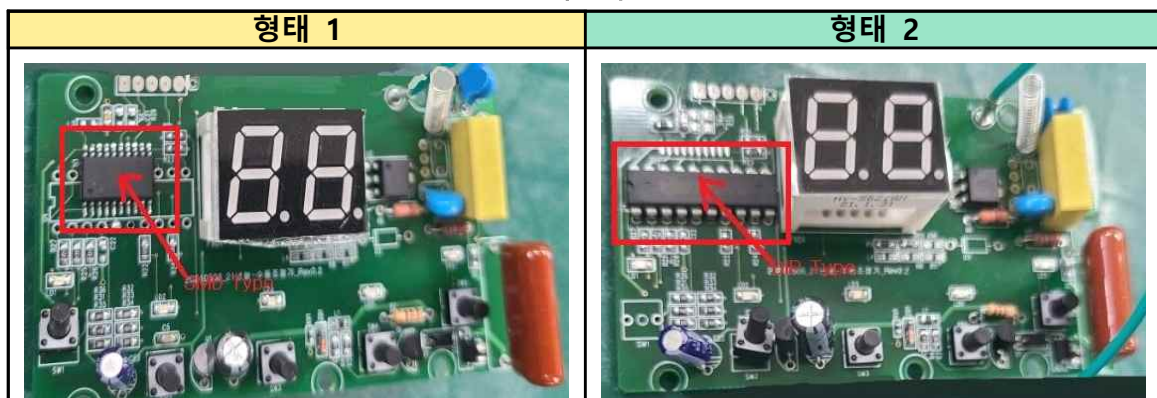
- 처음부터 동등한 기능의 MCU(IC칩)를 선택적으로 사용할 목적으로 PCB기판이 제작되었고, MCU의 회로, 전기적 성능은 동일한 경우,
 - 해당제품은 MCU의 크기와 핀 형태만 다른 경우에 해당하여 별도의 시험 없이 단순 변경 가능

※ 이 경우, 제5조제2항 각 호에 따른 전기적 특성의 동일성을 증명할 수 있는 관련 자료*를 제출

*전기적 특성의 동일성을 증명할 수 있는 관련 자료(고시 제5조제2항)

1. 저항 등 회로소자인 경우 기존 회로소자와의 전기적 특성 비교표
2. 부품이 시스템의 구성품인 경우 시험성적서

< 예 시 >



※ 회로, 전기적 성능은 같으며, 외부 패키지 타입만 다른 경우임